

## 技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所用與我們及我們的業務有關的若干技術詞彙。該等詞彙及其涵義未必與標準行業釋義或用法相符。

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「ADC」    | 指 | 自動缺陷分類，一套AI驅動的視覺檢測解決方案，旨在實現製造過程中缺陷檢測和分類的自動化      |
| 「AGV」    | 指 | 自動導引車，在受控製造設施內運輸物料的無人駕駛車輛                        |
| 「AI」     | 指 | 人工智能   |
| 「AIGC」   | 指 | 人工智能生成內容，即利用人工智能實現內容生成自動化，並根據用戶輸入的關鍵字或要求生成個性化內容  |
| 「AMHS」   | 指 | 自動化物料搬運系統，由計算機控制在整個工廠內自動運輸、存儲及管理物料的集成解決方案        |
| 「APS」    | 指 | 高級計劃排產，優化生產排期和資源的智能系統                            |
| 「Auto3」  | 指 | 半導體行業第三代自動化系統或技術，指相較於舊版本有所改進或提升的迭代或版本            |
| 「BC」     | 指 | 區塊控制，一個基於工業物聯網技術的智能製造協同平台                        |
| 「BI」     | 指 | 商業智能，即用於收集、分析及呈現數據的技術、策略與方法論組合，幫助組織做出更優化的數據驅動決策。 |
| 「CD-SEM」 | 指 | 臨界尺寸掃描電子顯微鏡，一種專門用於半導體製造中精確測量晶圓上微小圖案尺寸的掃描電子顯微鏡    |

---

## 技術詞彙表

---

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「CIM」  | 指 | 計算機集成製造，使用計算機控制整個生產過程的製造方法  |
| 「CP」   | 指 | 芯片探測（也稱為晶圓測試）是半導體製造流程中的關鍵步驟，位於晶圓製造和芯片封裝之間，主要用於驗證晶圓級未封裝芯片單元（Die）的電氣特性和功能 |
| 「CTC」  | 指 | 集群設備控制系統，一種用於監控和協調組件模塊的複雜監控控制軟件系統                                       |
| 「CTF」  | 指 | 集群工具架構，專有的國產半導體設備軟件平台，為設備製造商提供高效、靈活且可擴展的軟件解決方案。                         |
| 「DC」   | 指 | 數據採集平台，一個收集並整合來自不同來源的數據的智能平台  |
| 「DRAM」 | 指 | 動態隨機存儲器，一種用作計算機主存儲器的揮發性內存，將數據存儲在由電容器和電晶體組成的記憶單位中                        |
| 「EAP」  | 指 | 設備自動化系統，通過設備直連強化生產流程管理的綜合系統   |
| 「EDA」  | 指 | 工程數據分析，通過分析工程數據以支持決策的系統   |
| 「EHM」  | 指 | 設備健康管理，將設備工藝參數整合至統一數據分析框架的平台  |
| 「ERP」  | 指 | 企業資源規劃，通過將數據整合至統一的中央數據庫來助力企業管理及精簡供應鏈、銷售等核心流程的集成軟件系統                     |

---

## 技術詞彙表

---

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「FDC」      | 指 | 智能錯誤偵測分類，通過數據收集、統計分析及AI驅動建模，實時監控關鍵設備參數的穩定性並將故障分類的智能設備管理平台                   |
| 「GEM」      | 指 | 通用設備模型，標準化的數字模板，使製造設備能夠被工廠主機系統監控與控制   |
| 「GloryIGI」 | 指 | 哥瑞利工業通用智能，通過統一專有知識管理、行業數據資產和端到端系統互操作性，推動整體智能化轉型的平台，使企業能夠優化從工藝工程到決策智能等關鍵工作流程 |
| 「GUI」      | 指 | 可配置圖形用戶界面，允許用戶通過圖形化圖標和音頻指示器與電子設備交互的用戶界面格式                                   |
| 「HMI」      | 指 | 人機界面，人類與機器或系統交互的接入點   |
| 「IDM」      | 指 | 集成設備製造商，設計、製造及銷售集成電路產品的半導體公司  |
| 「IMSS」     | 指 | 智能製造軟件解決方案，連接機器、流程與數據的集成平台，可實現自動化生產、實時監控性能並在整個製造過程中優化決策                     |
| 「工業4.0」    | 指 | 第四次工業革命，其特點是通過將數字技術整合至製造流程，創建高度自動化、數據互聯並能實時響應數據的智能工廠與供應鏈，從而提升效率與生產力         |

---

## 技術詞彙表

---

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「物聯網」  | 指 | 物聯網，嵌入傳感器、軟件及網絡連接能力，使設備、車輛、家電等物理對象互聯形成的網絡系統  |
| 「J2EE」 | 指 | Java 2平台企業版，一套用於開發和部署可擴展的多層企業級應用程序的規範  |
| 「KM」   | 指 | 知識管理，一套生成、傳播、使用和監察組織的知識和數據的程序  |
| 「KVM」  | 指 | 鍵盤、視頻和鼠標，基於IP網絡的硬件解決方案，由主機和網絡接口等組件組成，主要用於服務器集群管理和工業控制                                |
| 「LC」   | 指 | 生產線控制系統，控制和監控製造過程中的特定區域或生產線  |
| 「LCD」  | 指 | 液晶顯示器，一種使用液晶和偏光片控制光線並構成圖像的薄而扁平的電子顯示器   |
| 「LED」  | 指 | 發光二極管  |
| 「裝載端口」 | 指 | 半導體製造工具上的自動化接口，用於接收晶圓載具以裝載或卸除晶圓以進入工藝加工   |
| 「LOFA」 | 指 | 黑燈工廠助理，一個整合了遠端集中控制、人工智能、工業視覺等尖端技術，可實現鏡頭倍率的自動調整、缺陷位置的精準識別，並通過遠端控制管理進行遠端自動化修復操作的智控數字平台 |
| 「MA」   | 指 | 製造助理（半導體行業的職位），職責包括協助半導體製造過程中的製造、測試和質量控制流程，確保製造過程的順利進行和產品合格                          |

---

## 技術詞彙表

---

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 「MCS」 | 指 | 物料控制系統，通過統一協議將跨品牌、跨類型的異構物料搬運設備進行集成的智能物流控制平台        |
| 「MES」 | 指 | 製造執行系統，為泛半導體和泛半導體行業量身打造提供生產排程、物料管理、設備管理、質量管理等功能的系統 |
| 「OCR」 | 指 | 光學字符識別，一個識別和提取設備界面文字、符號和數字的系統                      |
| 「OHT」 | 指 | 空中懸掛式搬送，專為半導體工廠內的物料搬運而設計的系統                        |
| 「OM」  | 指 | 光學測量，一種半導體製造業中主要使用自動視覺檢測和光學計量工具確保產品精度的質量保證方法       |
| 「PC」  | 指 | 個人電腦   |
| 「PCA」 | 指 | 主成分分析，一種將數據集轉換為一組正交成分，擷取數據中最大變異數的算法                |
| 「PCB」 | 指 | 印刷電路板，一種提供穩定基座和導電路徑以機械支撐和電氣連接電子元件的電子部件             |
| 「PCC」 | 指 | 工藝控制中心，一個實時監控和管理所有生產參數以保持最佳工藝條件的中心樞紐               |
| 「PDS」 | 指 | 工藝設計與仿真，是一款用於優化半導體製造流程的先進仿真和校正工具                   |
| 「PLC」 | 指 | 可編程邏輯控制器，用於自動化及控制製造流程的工業計算機                        |

---

## 技術詞彙表

---

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「PPT」  | 指 | 簡報圖形軟件(powerpoint)                                     |
| 「QMS」  | 指 | 質量管理系統，一個全面數字平台，用於整個泛半導體行業質量控制流程的標準化與自動化               |
| 「RCM」  | 指 | 遠程控制管理，軟硬件集成解決方案，旨在滿足先進製造業的各項需求，包括降低人工成本、提高生產效率及提升產品質量 |
| 「RMS」  | 指 | 配方管理系統，一套全面管理平台，旨在用於泛半導體行業和先進製造的設備配方控制的標準化與自動化         |
| 「RPA」  | 指 | 端到端業務自動化而設計的軟件解決方案，依托智能化技術，「替代人」進行重複性、低價值及規則明確的工作流程    |
| 「RTD」  | 指 | 實時排產，一種可確保及時有效地調度材料和產品的數據驅動方法                          |
| 「SECS」 | 指 | 半導體設備通信標準，該標準規定了半導體製造設備自動化和控制使用的數據交換的消息格式              |
| 「SEMI」 | 指 | 國際半導體設備與材料協會，制定和維護半導體行業標準的國際組織                         |
| 「SOP」  | 指 | 標準作業流程   |
| 「SPC」  | 指 | 統計過程控制，控制和提高過程質量的統計方法                                  |
| 「STK」  | 指 | 堆垛機  |
| 「TMS」  | 指 | 測試管理系統，管理測試過程和結果的系統                                    |

---

## 技術詞彙表

---

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 「VM」  | 指 | 虛擬量測，AI驅動的軟件解決方案，旨在通過將設備及工藝參數與統計及機器學習模型相結合，預測產品特性（如薄膜厚度、阻抗、線寬） |
| 「WAT」 | 指 | 晶圓驗收測試，晶圓廠在製造結束時生成的數據，通常向無廠半導體公司客戶提供有關每個晶圓的數據                  |
| 「WMS」 | 指 | 倉庫管理系統，管理和控制所有倉庫操作的系統  |
| 「YE」  | 指 | 良率提升，提高良率的過程   |
| 「YMS」 | 指 | 良率管理系統，一個用於優化泛半導體行業的產量和質量控制的先進分析平台                             |